

ALLEGATO X - REQUISITI MINIMI INDEROGABILI

FORNITURA DI UN SISTEMA PER SPIN COATING, BAKING E SVILUPPO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)

CIG 9259076F37

Tool	Caratteristica	Requisito minimo
Generale per spin coater+baking e sviluppatore	Garanzia di tutti i prodotti	12 mesi
	Installazione e training	sì
	Tempi di consegna	18 settimane
	Footprint massimo coater+baking	1400x1000 mm
	Footprint massimo sviluppatore	1000x1000 mm
	Massima taglia del wafer processabile	Maggiore o uguale a 8"
	Caricamento manuale del wafer	sì
	Interfaccia utente con diversi livelli di accesso al software	sì
	Funzioni start/stop rapide	sì
	Chiusura di sicurezza delle camere di processo	sì
	Aspirazione aree di processo per sicurezza operatore	sì
Spin coater e sviluppatore	Presenza arm per dispensing motorizzato con parametri di processo programmabili	sì
	Possibilità di memorizzare programmi	sì
	Numero di programmi/segmenti programmabili	Almeno 30 programmi da almeno 20 segmenti
	Chucks portawafer compresi	4", 6" e 8"
	Parametri di processo programmabili	sì
	Materiale camera di processo	Resistente ai chimici
Spin coater	Numero di linee per fotoresist comprese	2
	Massimo numero di linee per fotoresist installabili	4
	Numero linee azionate tramite motore	1
	Numero linee azionate pneumaticamente	1
	Possibilità dispensing manuale del PR	sì
	Possibilità di futura installazione di linea per edg bead removal (EBR)	sì

Allegato X – REQUISITI MINIMI INDEROGABILI
 FORNITURA DI UN SISTEMA PER SPIN COATING, BAKING E SVILUPPO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO)
 NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) – CIG 9259076F37

	Fissaggio wafer tramite vuoto	sì
	Massima velocità di rotazione per wafer da 8"	>=6000 rpm
	Accuratezza della velocità di rotazione	migliore di 5%
	Massima accelerazione/decelerazione	>=5000 rpm/s
	Schermi protettivi usa e getta	sì
	Tempo massimo di processo impostabile	>3600 s
Hot plate per baking	Dimensioni hotplate	> 220x220 mm
	Presenza di proximity pins removibili e con altezza controllabile	sì
	Step di controllo altezza proximity pins	sì
	Possibilità di priming con HMDS con ciclo di purge in azoto	sì
	Possibilità di chiudere il coperchio durante il bake	sì
	Possibilità di programmare rampe di temperatura	sì
	Numero segmenti per singolo programma	>10
	Limitatore di temperatura automatico per evitare surriscaldamento	sì
	Temperatura massima	> 200°C
	Accuratezza del valore di temperatura	+/- 1°C a 100°C
	Possibilità di livellare la piastra	sì
Sviluppatore	Numero linee per dispensing del developer comprese	1
	Numero massimo linee per dispensing del developer installabili	2
	Erogatore per acqua deionizzata e azoto montato sul braccio	sì
	Massima velocità di rotazione	> 2000 rpm
	Massima accelerazione	> 5000 rpm
	Velocità massima del braccio	> 150 mm/s
	Tempo massimo di processo	> 2000 s